

SAP-880H

全自動高分子組立機

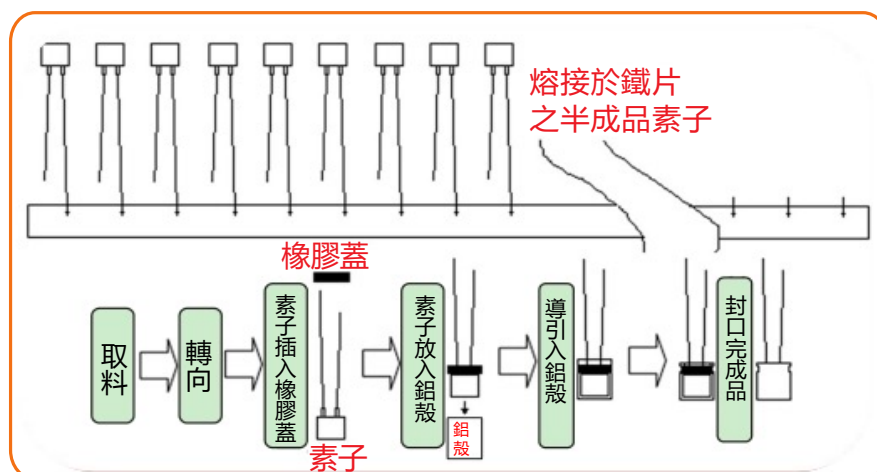
(固態電容：4Ø~10Ø；附料盤保溫烤箱)



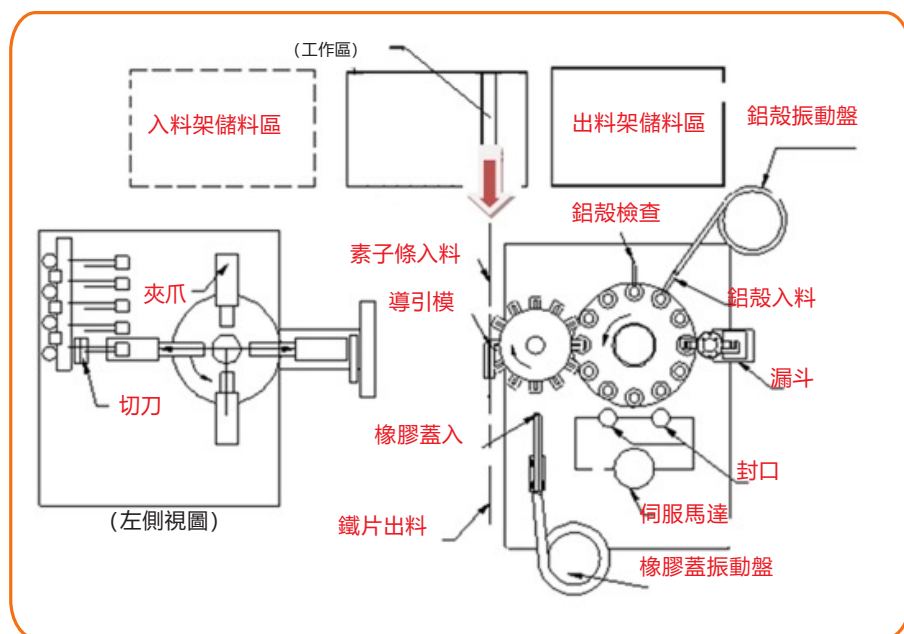
- 產品特性 -

1. 設備適用於固態高分子電容器，單機即可完成送料、組立、查檢製程，大幅降低人力與生產成本，並維持高產速。
2. 設備結合自動送料、取料、入料、CP 線檢查、不良排除、素子&鋁殼&膠蓋組立、素子結合膠蓋整平、束腰、分腳、封口、束腰封口檢查、選別(良品/不良品)、自動夾出等多項功能。
3. 入料料盤軌道設有保溫加熱烤箱，保持素子乾燥阻絕空氣濕氣，溫度(0~150度)可依製程調整。
4. 具備素子歪斜扶正機構(素子本體高度需超過 5mm)，確保素子組立過程保持直立。
5. 採用膠蓋固定，拉取素子 CP 線的組裝方式，避免素子釘接點受損造成接觸不良情況發生。
6. 具備素子、膠蓋、鋁殼組立異常檢測機構，檢測內容為素子過大&組立不完全，異常發生時可即時停機。
7. 配置雙封口針設計，封口尺寸穩定。束模轉盤採高精度分割器機構，確保裸品尺寸一致性。
8. 人機可依製程需要設定封口針、束腰輪、倒角輪使用次數，次數到達時即時警報提醒。
9. 人機可依製程需要設定封口針、束腰輪、倒角輪使用次數、次數到達時即時警報提示。可選配 CCD 影像系統檢查裸品封腰尺寸、裸品高度、CP 線尺寸，確保良品品質。(選配)
10. 可選配正負極短路檢測機構及鋁殼內墊紙安裝機構，確保產品無短路情況發生。(選配)
11. 可選配振動盤(鋁殼&膠蓋)保溫功能，保持素子乾燥阻絕空氣濕氣(選配)
12. 支援人性化控制介面設計，所有生產資訊在人機螢幕上一覽無遺。並配置工業 4.0 資料傳輸功能。
13. 可加裝Barcode(1, 2維)條碼掃描系統，將生產工單號碼自動帶入。(選配)

- 設備配置 -



- 製程料品 -



- 產品規格 -

項目	說明
適用產品	4 ~ 10 Ø
外型尺寸 (CM)	215 (L) × 225 (W) × 185(H)
設備重量(KG)	約 1100 Kg
控制方式	PLC 程序控制
電源需求	3Ø; AC 220V 或 AC 380V; 50/60HZ

- 適用規格 - (單位: mm)

*產速依客戶材料與製程不同而存在差異

	4Ø	5Ø	5.3Ø	6.3Ø	8Ø	10Ø
鋁殼外徑	4± 0.03	5± 0.03	5.3± 0.03	6.3± 0.03	8± 0.03	10± 0.03
鋁殼長度	5.7 ~ 10.0	4.5 ~ 7.0 7.0 ~ 12.0	4.5 ~ 7.0 7.0 ~ 12.0	4.5 ~ 12.0 12.0 ~ 17.0	5.7 ~ 12.0 12.0 ~ 21.0	5.7 ~ 12.0 12.0 ~ 21.0
膠蓋外徑	3.4	4.35	4.35	5.65	7.3	9.3
膠蓋厚度	1.5	1.6	1.6	1.6	1.8	2.7
膠蓋孔距	1.6	2.1	2.1	2.6	3.8	5.1
機械速度± 10%	約50	約60 ~ 70	約60 ~ 70	約60 ~ 70	約50 ~ 65	約50 ~ 65

